

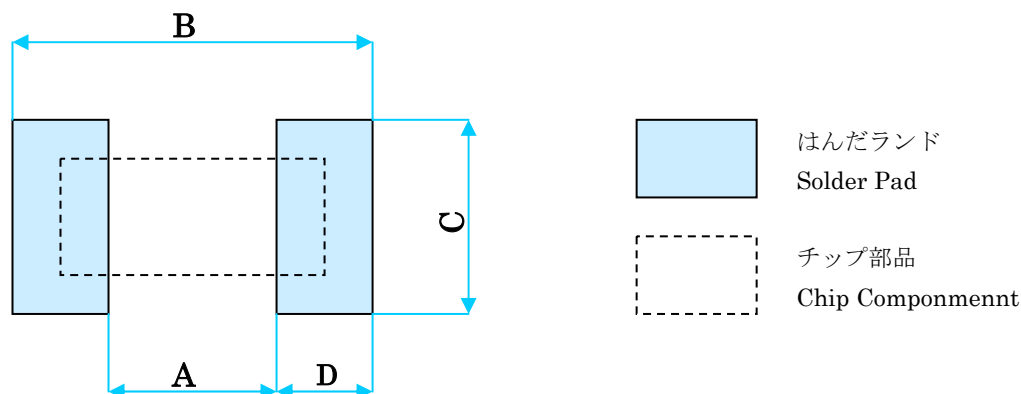
推奨ランド寸法

RECOMMENDED PAD DIMENSIONS

推奨ランド寸法 RECOMMENDED PAD DIMENSIONS

はんだ付け時の最適ランド寸法は条件によって異なりますが、標準的には下記のランド寸法を推奨します。

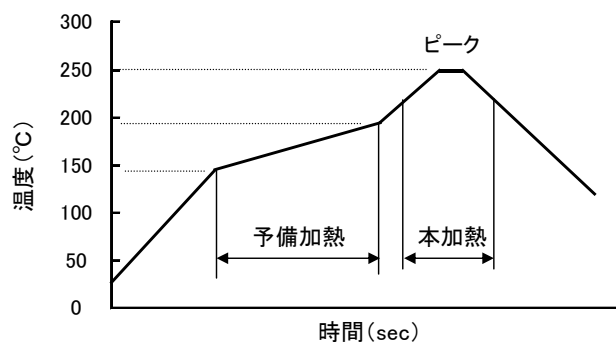
The optimum dimension of soldering pad at the time of soldering differs according to conditions, however, the following pad dimensions are recommended as standard.



形式 Style	寸法 Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
SRS1AZ	3.2	7.2	3.0	2.0
SRL1SZ	4.5	8.5	3.0	2.0
SRL2Z	7.9	13.5	4.5	2.8
SRL3Z	9.9	15.5	6.5	2.8
RL・RCP1/2W	0.7	3.5	3.1	1.4
RL・RCP1WS	1.0	7.6	5.1	3.3
RL・RCP1W	1.0	8.0	4.5	3.5
RL・RCP2W	1.0	8.0	6.4	3.5
RL・RCP3W	3.8	10.0	10.0	3.1
RC0603	0.25	0.8	0.5	0.275
RCL・RCH・RC 1005	0.5	1.9	0.7	0.65

形式 Style	寸法 Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
RCL・RCH・RC 1608	1.0	2.5	1.0	0.75
RCL・RCH・RC 210	1.3	2.9	1.5	0.8
RCL・RCH・RC 315	2.2	4.2	1.8	1.0
RCL・RCH・RC 325	2.2	4.2	2.9	1.0
RCL・RCH・RC 525	3.3	6.1	2.9	1.4
RCL・RCH・RC 633	4.6	8.0	3.3	1.7

推奨リフロープロファイル RECOMMENDED REFLOW PROFILE



	温度 Temperature	時間 Time
予備加熱 Preheating	140~190°C	60~120sec
本加熱 Soldering	220°C以上	30~40sec
ピーク Peak	250°C	5sec 以内

- 適用ハンダ：Sn3Ag0.5Cu
- リフロー回数：2回まで